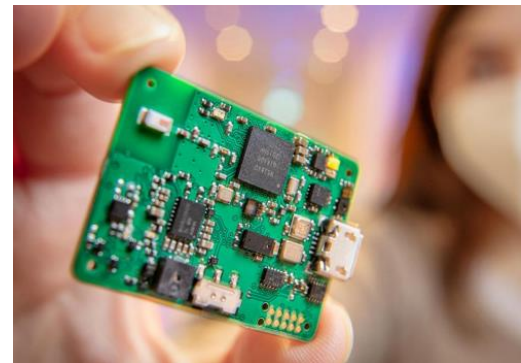


Kompetenzen

- Textil-Elektronik-Integration
- Mikrobatterien und –harvester
- Smart-Sensor-Nodes für Wearables (w-IoT)
- Embedded E2E Encryption (4E)

Aktuelle Themen

- Hardware integrierter Tampering-Schutz
- SWARM Sensorknoten für Multisensoren
- Datensparsamkeit durch “embedded” Vorverarbeitung (Datensparsamkeit)
- Kooperation zu sog. “HW-Oracles”, dh. bereits hardware-nah unveränderliche Daten zur Einspeisung in Blockchains



Kontakt

Erik Jung, erik.jung@izm.fraunhofer.de



